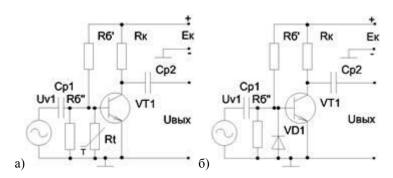
54. Термостабилизация рабочей точки. Эмиттерная стабилизация.

1) При нагревании рабочая точка смещается по нагрузочной прямой, что приводит к увеличению коллекторного тока Ік и уменьшению напряжения Uкэ. Это равносильно приоткрыванию транзистора. Поэтому основной задачей температурной стабилизации является синхронная с увеличением температуры стабилизация положения рабочей точки. На рис.а) показана схема с использованием терморезистора.



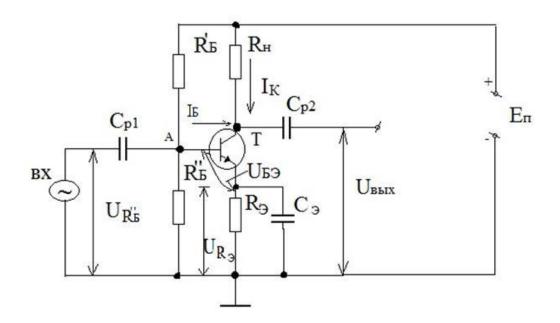
При нагревании сопротивление терморезистора уменьшается, что приводит к общему уменьшению сопротивления включеных в параллель резисторов R6" и Rt. За счет этого напряжение ибэ будет уменьшаться, эмиттерный переход подзапираться, и рабочая точка сохраняет своё положение на нагрузочной прямой.

Аналогичным образом происходит термостабилизация рабочей точки полупроводниковым диодом рис.б).

При увеличении температуры сопротивление диодов в обратном включении будет уменьшаться за счет термогенерации носителей заряда в полупроводнике. Общее сопротивление включенных параллельно резистора R6" и диода VD1 будет уменьшаться, что приведет к уменьшению напряжения Uбэ, транзистор подзапирается и рабочая точка сохраняет свое положение.

Недостатком схем с терморезистором и полупроводниковым диодом является то, что и терморезистор, и полупроводниковый диод должны подбираться по своим температурным свойствам для каждого конкретного транзистора. Поэтому наиболее часто применяют схемы температурной стабилизации отрицательной обратной связью (ООС) по постоянному току и напряжению.

2) Такая схема получила наибольшее распространение на практике.



$$I_{\mathit{K}} = \beta I_{\mathit{E}}\,,_{_{\mathsf{HO}}} I_{\mathit{E}} = f_{1}(U_{\mathit{E}\mathfrak{I}}),_{_{\mathsf{3HAYUT}}} I_{\mathit{K}} = f_{2}(U_{\mathit{E}\mathfrak{I}}),_{_{\mathsf{HO}}}$$

$$U_{\mathcal{B}\mathfrak{I}}=U_{\mathcal{A}}-U_{\mathcal{R}_{\mathfrak{I}}}; U_{\mathcal{A}}=\frac{E_{n}R_{\mathcal{B}}^{"}}{R_{\mathcal{B}}^{"}+R_{\mathcal{B}}^{'}}=const,$$

$$U_{\rm B9} = f_{\rm 3}(U_{\rm R_{\rm 3}}); U_{\rm R_{\rm 3}} = f_{\rm 4}(I_{\rm 9}); I_{\rm 9} \approx I_{\rm K}$$

Пусть по какой-либо причине (например, увеличение температуры или смена транзистора T) возрос β , тогда начнет увеличиваться Iк, а значит и Iэ. Это приведет к увеличению URэ, но уменьшит UБЭ, т.к. Uбэ=const-URэ, что приведет к уменьшению IБ, вследствие чего ограничится рост Iк.

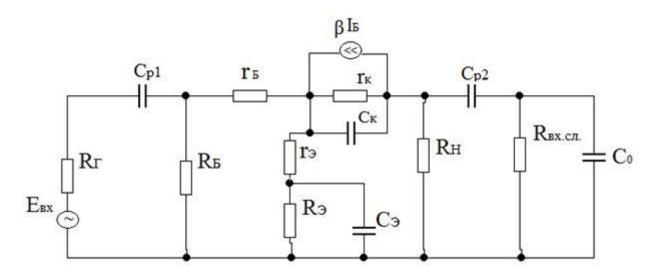
Схематически эмиттерную стабилизацию можно представить:

$$\uparrow \beta \to \uparrow I_{K} = \beta I_{E} \approx \uparrow I_{\Im} \to \uparrow U_{R_{\Im}} \to \downarrow U_{E\Im} \to \downarrow I_{E} \to \downarrow I_{K}.$$

При этом ΔІк↑≈ΔІк↓, что обеспечивает высокую стабильность Ік.

Рассмотренные схемы стабилизации усилительных каскадов на транзисторах, включенных по схеме с OЭ, широко применяется при построении усилителей переменного напряжения, и в частности в УНЧ.

<u>Полная эквивалентная схема УНЧ с емкостной межкаскадной связью на основе биполярного</u> транзистора, включенного по схеме с ОЭ.



$$R_{\rm E} = \frac{{R_{\rm E}}'{R_{\rm E}}''}{{R_{\rm E}}' + {R_{\rm E}}''}; C_0 \approx C_{\rm ex.cs} + C_M;$$

Свх.сл. – входная емкость следующего каскада.

См – суммарная монтажная емкость схемы.

Из эквивалентной схемы видно, что существенное влияние на AЧX усилителя оказывают емкости Cp1, Cэ, Cк, Cp2, C0, поэтому важно знать о критериях выбора этих емкостей.

В области нижних граничных частот fн полосы пропускания усилителя необходимо выполнение условий:

$$\begin{split} &X_{cp_1} << R_{\rm ex}; X_{cs} << R_{\rm s}; X_{cp_2} << R_{\rm ex.cn} \\ &\text{2de}: R_{\rm ex} = R_{\rm E} \parallel r_{\rm E} = \frac{R_{\rm E} r_{\rm E}}{R_{\rm E} + r_{\rm E}} \end{split}$$

Эти условия выполняются на практике при следующих соотношениях:

$$\frac{1}{2\pi f_{H}C_{p_{1}}} \leq 0.1R_{ex}; \frac{1}{2\pi f_{H}C_{\Im}} \leq 0.1R_{\Im}; \frac{1}{2\pi f_{H}C_{p_{1}}} \leq 0.1R_{ex.c\pi}$$

Откуда получаем:

$$\begin{split} C_{p_{1}} &= \frac{10*10^{6}}{2\pi f_{H}R_{\rm ex}}, ({\rm MK\Phi}) \\ C_{9} &= \frac{10*10^{6}}{2\pi f_{H}R_{\rm s}}, ({\rm MK\Phi}) \\ C_{p_{2}} &= \frac{10*10^{6}}{2\pi f_{H}R_{\rm ex,col}}, ({\rm MK\Phi}) \end{split}$$

В области средних частот полосы пропускания влиянием всех емкостей на АЧХ можно пренебречь.

В области верхних граничных частот fв полосы пропускания усилителя необходимо выполнение условий:

$$X_{C_{\kappa}}>>r_{k}; X_{C_{0}}>>R_{\mathrm{ex.cr}},$$
 следовательно:
$$\frac{1}{2\pi f_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{K}}}\geq 0, 1r_{k}; \frac{1}{2\pi f_{\mathrm{B}}C_{0}}\geq R_{\mathrm{ex.cr}}$$

Откуда получаем:

$$\begin{split} C_{\it K} \leq & \frac{10*10^{12}}{2\pi\,f_{\it B}r_{\it k}}, (n\Phi) - \text{определяет выбор транзистора по критерию } \mathrm{C}_{\it k} \\ C_0 \leq & \frac{10*10^{12}}{2\pi\,f_{\it B}R_{\rm ex,col}}, (n\Phi) \end{split}$$

Определяет выбор транзистора по критерию Ск.

АЧХ усилителя с емкостными межкаскадными связями.

